球型硅微粉 高白玻璃粉 软性硅微粉

产品名称	球型硅微粉 高白玻璃粉 软性硅微粉
公司名称	东海县晶盛源硅微粉有限公司
价格	11.00/kg
规格参数	东海晶盛源:东海
公司地址	东海县牛山镇万花山开发区227省道西侧地质队北侧
联系电话	15261308899 15161323602

产品详情

球型硅微粉

【基本说明】：球形硅微粉是东海晶盛源公司以天然优质粉石英矿物为基本原料，在分散剂和球形催化剂存在的条件下，经独特工艺加工而成

的一种高强度、高硬度、惰性

的球型颗粒。高品质球型硅微粉，具有极低

的吸油率、混合粘度

和摩擦系数。其独特的球粒结构，与其他棱角形石英粉（硅微粉）相比，粉体流动性好，粉体堆积形成的休止角小，因而在与有机高分子材料

混合时分密实，增强机体的强度。易分散、混料均匀、可明显增加材料的流动性。

我司产品规格表：

球型硅微粉规格									
400目	600目	800目	1000目	1250目	1500目	2000目	4000目	6000目	8

◇ 球形硅微粉的优势

1、球形硅微粉的表面流动性好，与树脂搅拌成膜均匀，树脂添加量小，并且流动性最好，粉的填充量可达到最高，重量比可达90.5%，因此，球形化意味着硅微粉填充率的增加，硅微粉的填充率越高，其热膨胀系数就越小，导热系数也越低，就越接近单晶硅的热膨胀系数，由此生产的电子元器件的使用性能也越好。

2、 球形化制成的塑封料应力集中最小，强度最高，因此球形粉塑封料封装集成电路芯片时，成品率高，并且运输、安装、使用过程中不易产生机械损伤。

3、球形粉摩擦系数小，对模具的磨损小，使模具的使用寿命长，与角形粉的相比，可以提高模具的使用寿命达一倍。

球型硅微粉的基本特性：

项目	单位	典型值
外观	-	白色粉末
白度	%	95-98
H2O	%	0.05
莫氏硬度	-	7
密度	g/cm3	2.65
SiO2	%	≥99.6
球化率	%	>95
电导率	um/cm	0.1
熔点	℃	1750

◇球型硅微粉用途：主要用于大规模集成电路封装，在航空、航天、精细化工、可擦写光盘、大面积电子基板、特种陶瓷及日用化妆品等高新技术领域也有应用，它在环氧树脂体系中作为填料后，可节约大量的环氧树脂。

备注：本公司也可根据客户需要进行加工更多详情，请来电咨询。